



ENABLING THE DIGITAL WORLD

ASM ProcessLens

下一代5D内联SPI

ASM ProcessLens

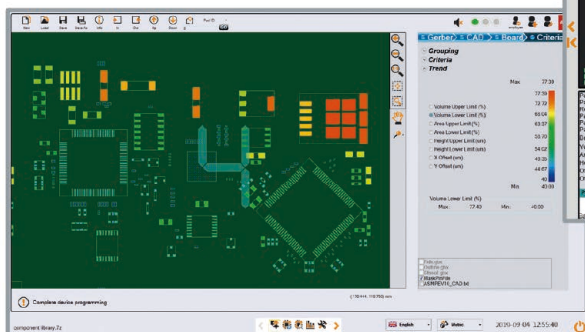
更快、更精确， 为未来做好准备

ASM ProcessLens是一个全新的、高精度的、非常灵活的5D内联SPI系统。ASM ProcessLens的技术进步创建了下一代SPI系统，该系统具有更简单、更灵活的编程和更精确、更可靠的测量，并且对于使用双通道传输带的内联测量速度足够快。其独特的准确性水平降低了假警报发生的可能，并大大减少了停线和需要协助的次数。

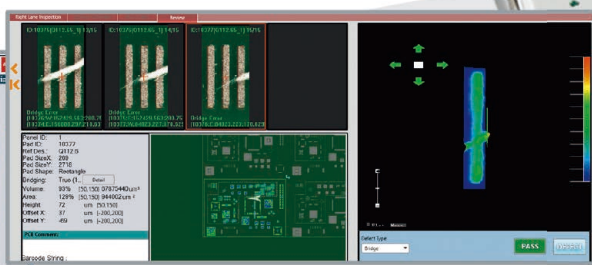
这是全球首个采用特殊的拥有800万个数控微镜的DLP（数字投影器）芯片的SPI。通过使用莫尔图案投影工艺和多个光源进行无阴影测量，ASM ProcessLens具有比传统系统更快、更准确地检测焊料沉积物的特性。高分辨率2D图像，PCB翘曲的3D动态补偿和功能强大的图像处理算法可进一步提高测量质量。

结果：带来更稳定的印刷流程、更高的吞吐量以及更高的产量。在竞争中脱颖而出。

快速编程：
元器件库建
议检查标准



焊膏沉积的3D和2D图像



您工厂的未来 易于改造的智能流程优化

使用可选的ASM ProcessEngine软件，您可以将5D SPI升级为全球首款用于优化印刷流程的自助学习内联专家系统。

使用虚拟印刷、趋势分析和直接印刷机控制，ASM ProcessExpert可以主动优化印刷流程——甚至可视需要自主优化，而无需手工协助。

ASM ProcessExpert可从每一个印刷周期中全年无休地进行学习，它从不忽略任何细节。



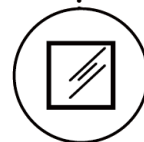
ASM ProcessLens 提供所有这些功能



所有系统均可使用：ASM ProcessExpert
确保所有印刷过程始终稳定。

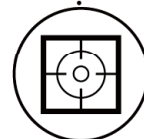
最具创新性的测量系统

使用800万数控显微镜的莫尔相移



最大精度

精确的X/Y定位，2D/3D测量
相结合，并动态补偿板卡翘曲



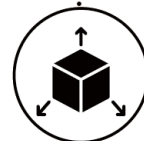
无阴影

多个光源



全面

显示所有焊料沉积的位置、覆盖范围、
高度、体积和形状；共面性和桥接检查



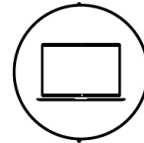
最大产量

在双运输带模式下内联测量



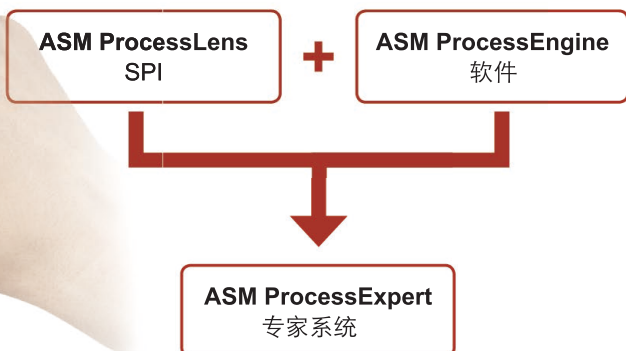
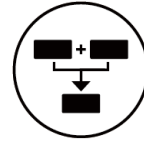
易于操作

使用元器件库快速编程并推荐检查标准



投资保护

可用的软件升级到内联专家系统
ASM ProcessExpert以进行自主流程优化



关于ASM ProcessLens
的更多信息，请扫描



ASM ProcessLens

| ASM ProcessLens占地面积 | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| PCB传输方向的长度 | 1,130 mm | | | | | | | | |
| 宽 | 1,300 mm | | | | | | | | |
| 高 (一条传输带高950mm) | 1,600 mm | | | | | | | | |
| ASM ProcessLens传输带 | | | | | | | | | |
| 上板/下板时间——单通道 上板/下板时间——双通道 | 低于2.5 s 0 s | | | | | | | | |
| 轨道通讯接口 | SMEMA或IPC-HERMES-9852 | | | | | | | | |
| ASM ProcessLens PCB | | | | | | | | | |
| PCB尺寸 (长 x 宽) ——单轨 PCB尺寸 (长 x 宽) ——双轨 (标准) PCB尺寸 (长 x 宽) ——双轨 (单轨模式) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>最小</th> <th>最大</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 mm × 50 mm</td> <td>610 mm × 560 mm</td> </tr> <tr> <td>50 mm × 45 mm</td> <td>375 mm × 260 mm</td> </tr> <tr> <td>50 mm × 45 mm</td> <td>375 mm × 460 mm</td> </tr> </tbody> </table> | 最小 | 最大 | 50 mm × 50 mm | 610 mm × 560 mm | 50 mm × 45 mm | 375 mm × 260 mm | 50 mm × 45 mm | 375 mm × 460 mm |
| 最小 | 最大 | | | | | | | | |
| 50 mm × 50 mm | 610 mm × 560 mm | | | | | | | | |
| 50 mm × 45 mm | 375 mm × 260 mm | | | | | | | | |
| 50 mm × 45 mm | 375 mm × 460 mm | | | | | | | | |
| PCB厚度范围 | 0.5 mm到4.5 mm | | | | | | | | |
| 最小PCB边缘间隙 | 3 mm | | | | | | | | |
| 板卡最大重量 | 3 kg | | | | | | | | |
| PCB最大翘曲范围 | -4.5 mm到+4.5 mm | | | | | | | | |
| ASM ProcessLens检查功能 | | | | | | | | | |
| 相机解析度 | 15 μm × 15 μm | | | | | | | | |
| 检查速度 | 高达30 cm ² /s | | | | | | | | |
| 高度分辨率 | 0.37 μm | | | | | | | | |
| 校准目标高度精度 | ≤ 1 μm | | | | | | | | |
| X/Y精度 | ± 12.5 μm (at ± 3σ) | | | | | | | | |
| ASM ProcessLens焊膏检查功能 | | | | | | | | | |
| 测量优势 | 2D+3D,无阴影干扰,板弯实时补偿。 | | | | | | | | |
| 焊膏测量类型 | 体积、面积、高度、X和Y偏移、形状、桥接、共面性 | | | | | | | | |
| 焊膏最大高度 | 1,000 μm | | | | | | | | |
| 焊膏最小尺寸 | 90 μm × 130 μm | | | | | | | | |
| Gage R&R on pasted PCB | << 10 % | | | | | | | | |

www.billionsunshk.com

深圳市亿阳电子仪器有限公司

地址：深圳市光明新区华强创意产业园二期3栋C座604单元

电话：+86 755 8657 3062

手机：189 2345 1117

1/09-2019版 | 保留所有权利 | 订购号：A10011-ASM-F15-CH | 中国印刷 | © ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG

本手册中的信息包含一般说明和/或性能特性，可能与所述的具体产品不符，或可能随着技术的发展或进步而发生变化。仅在达成协议的情况下，特定性能特性和/或功能才具有法律效力。所有产品名称均为ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG或其他供应商的品牌或者商标。第三方使用需经所有者授权。